

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2025-014

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明会，针对公司2024年经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2025年5月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临2025-012），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2025年5月22日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2024年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题1：**请问，公司本期盈利水平如何？

**回答：**2024年以来公司业务规模与盈利能力显著提升，2024年度实现营业

收入 11.30 亿元,同比上升 23.72%;实现归母净利润 2.53 亿元,同比上升 68.40%; 2025 年一季度,实现营业收入 2.91 亿元,同比增长 20.74%;实现归母净利润 0.65 亿元,同比增长 32.73%。

**问题 2:** 请问,今年封测业务(汽车电子、消费电子、安防)及光学器件业务市场需求情况如何?

**回答:** 随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展,车载摄像头的应用越来越广泛,单车摄像头搭载数量和价值量都在不断提升,带动市场需求快速增长,公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级 TSV 封装技术的领先者,通过技术工艺的持续创新、增加量产规模,提升生产效率,封装业务规模相应呈现显著增长态势。

对于光学器件业务,2024 年业务规模整体平稳,通过 2024 年以来对技术、产品的开发拓展,有效提升荷兰、苏州双光学中心的光学设计、技术开发与制造能力,一方面通过聚焦半导体等领域核心客户需求,不断拓宽混合镜头业务应用,并从光学器件向光学模块、光机电系统延伸拓展;另一方面不断提升晶圆级光学器件(WLO)的工艺水平与量产能力,积极推进在汽车智能投射领域的新产品开发与商业化应用。

**问题3:** 请问, AI眼镜、机器人等新兴领域发展很快,公司年报提到在这些领域已有效实现商业化量产,请介绍下相关业务的增长前景和市占率情况?

**回答:** 公司为全球影像传感芯片晶圆级 TSV 封装技术的引领者,封装的产品广泛应用在智能汽车、AI眼镜、机器人等新兴应用领域。随着技术的不断迭代发展, AI 智能眼镜融合视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为 AI 技术落地的最佳场景之一;在 AI 大模型的赋能推动下,机器人通过“视觉”系统与环境交互,开始具备迁移学习的能力,通用化应用进程大幅推进。AI眼镜、机器人等新兴应用领域的快速发展,将带动视觉传感器市场需求的快速增长。

**问题4:** 请问,公司介绍重点研发方向包括车载激光雷达、车载 MEMS、5G 射频芯片封装技术等,年报中提到作为牵头单位推进的高端 MEMS 芯片先进封测项目顺利完成中期检查,在 MEMS、滤波器领域已实现规模量产,请介绍下公司在相关领域的技术优势和业务增长前景如何?

**回答:** 公司通过技术持续创新,不断开发 TSV-Last、Cavity -last 相关工艺,陆续在 MEMS、滤波器等新应用领域取得突破,实现规模化量产,有效拓展晶圆

级TSV封装技术的市场应用。随市场应用的不断发展，公司将不断提升业务规模、积极拓展未来业务发展新的增长驱动。

**问题5：**美国贸易政策不稳定对公司业务的影响，未来两年是否有进一步海外设厂或收购计划。

**回答：**为应当前国际贸易与产业重构发展趋势，公司主动求变，积极推进公司市场拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，一方面依托新加坡子公司平台，对海外子公司及项目投资架构进行规划调整，有效搭建国际化的投融资平台；另一方面积极推进在马来西亚槟城的生产基地建设，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位。

**问题6：**请问，公司之后的盈利有什么增长点？

**回答：**公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球传感器领域晶圆级TSV封装技术的领先者。随着汽车智能化、机器人、AI眼镜等应用领域的快速发展，将为公司业务发展带来有效增长驱动，尤其在汽车电子领域，公司将通过发挥技术持续创新、市场地位与产业能力优势，不断提高行业壁垒，提升产业领先优势；同时通过工艺持续创新，公司不断拓展MEMS、FILTER等非CIS应用领域，实现商业化量产，相关领域也将成为公司未来业务发展新的增长驱动。

### 三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年5月23日